

MMBZ30VCL 双通道 ESD 保护

1 特性

- 4.5pF (典型值) 的超低 I/O 电容
- 低漏电流 <25nA
- 双通道单向 ESD 保护或单通道双向 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 ESD 保护：
 - $\pm 30\text{kV}$ 接触放电
 - $\pm 30\text{kV}$ 气隙放电
- 温度范围：-55°C 至 +150°C
- 引线式封装，用于自动光学检测 (AOI)

2 应用

- 通用 IO 保护
- 工业控制网络：
 - DeviceNet
 - 智能配电系统
- 音频
- 电信

3 说明

MMBZ30VCL 是一款采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有低电容和低漏电流特性，可用于高速应用。低动态电阻允许低钳位电压，有助于保护系统免受瞬态事件的影响。

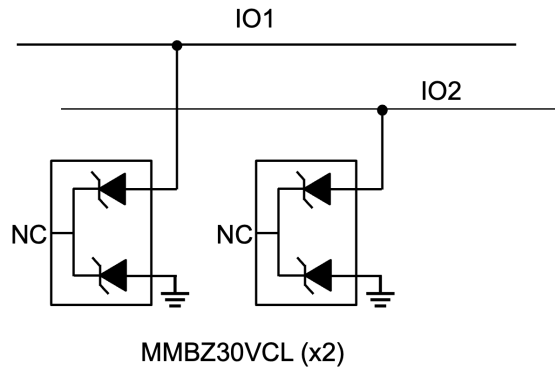
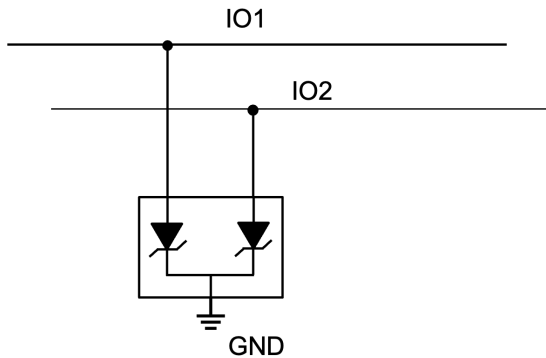
MMBZ30VCL 采用 SOT-23 封装，可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
MMBZ30VCL	DBZ (SOT-23, 3)	2.92mm × 2.37mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 8。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



典型应用



内容

1 特性.....	1	5.7 典型特性.....	5
2 应用.....	1	6 器件和文档支持.....	6
3 说明.....	1	6.1 文档支持.....	6
4 引脚配置和功能.....	3	6.2 接收文档更新通知.....	6
5 规格.....	3	6.3 支持资源.....	6
5.1 绝对最大额定值.....	3	6.4 商标.....	6
5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格.....	3	6.5 静电放电警告.....	6
5.3 ESD 等级 - IEC 规格.....	3	6.6 术语表.....	6
5.4 建议运行条件.....	4	7 修订历史记录.....	6
5.5 热性能信息.....	4	8 机械、封装和可订购信息.....	6
5.6 电气特性.....	4		

4 引脚配置和功能

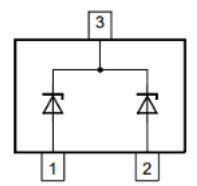


图 4-1. DBZ 封装，3 引脚 SOT-23 (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		说明
名称	编号	
AN1	1	二极管 1 的阳极
AN2	2	二极管 2 的阳极
CC	3	共阴极

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
P _{PP}	25°C 时的 IEC 61643-321 功率 (t _p - 10/1000μs)		20	W
I _{PP}	25°C 时的 IEC 61643-321 电流 (t _p - 10/1000μs)		0.5	A
T _A	自然通风条件下的工作温度范围	-55	150	°C
T _J	结温	-55	150	
T _{stg}	贮存温度	-65	155	

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2500	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JS-002 ⁽²⁾	±1000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 ESD 等级 - IEC 规格

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	IEC 61000-4-2 接触放电，所有引脚	±30000	V
		IEC 61000-4-2 空气间隙放电，所有引脚	±30000	

5.4 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
T_A	自然通风条件下的工作温度范围	-55		150	°C

5.5 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		MMBZ30VCL	单位
		DBZ (SOT-23)	
		3 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	262.6	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	147.0	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	96.1	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	33.5	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	95.4	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体](#)和[IC 封装热指标](#)应用报告。

5.6 电气特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 条件下（除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_F	正向电压	$I_F = 10\text{mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$			1.1	V
V_{RWM}	反向关断电压	$T_A = 25^\circ\text{C}$			24	V
V_{BR}	击穿电压 ⁽¹⁾	$I_T = 10\text{mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$	24.8		34.8	V
V_{CLAMP}	钳位电压 ⁽²⁾	$I_{PPM} = 0.5\text{A}$, $t_p = 10/1000\mu\text{s}$		31	40	V
I_{LEAK}	漏电流	$V_{IO} = \pm 24\text{V}$		1	25	nA
S_Z	温度系数	$I_Z = 10\text{mA}$		13		mV/C
C_L	线路电容	$V_{IO} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$, $V_{pp} = 30\text{mV}$		4.5		pF

(1) V_{BR} 定义为器件进入浅快速复位状态前，施加 10mA 时的电压

(2) 根据 IEC 61643-321，器件承受 10/1000 μs 指数衰减波形的应力

5.7 典型特性

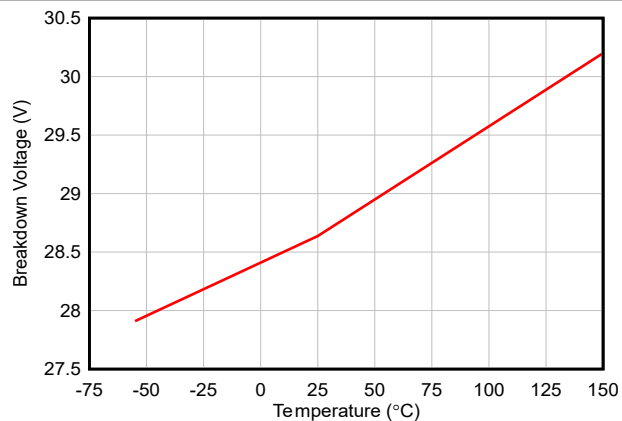


图 5-1. 击穿电压与温度间的关系

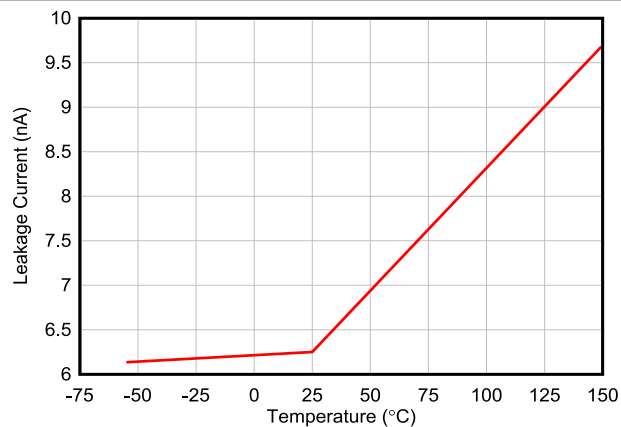


图 5-2. 漏电流与温度间的关系

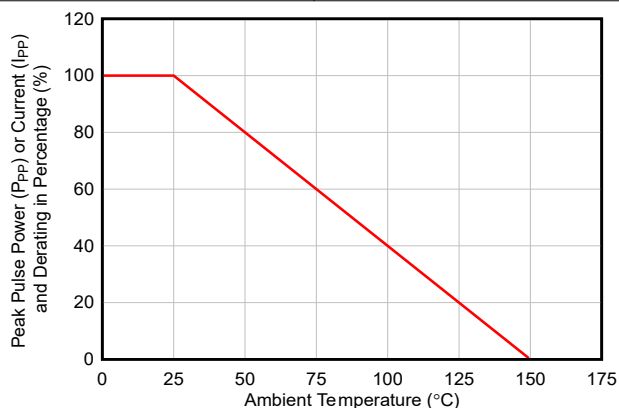


图 5-3. 峰值脉冲功率降额曲线

6 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

6.1 文档支持

6.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [ESD 布局指南应用报告](#)
- 德州仪器 (TI), [通用 ESD 评估模块用户指南](#)
- 德州仪器 (TI), [为超高速数据线路选择 ESD 二极管应用报告](#)
- 德州仪器 (TI), [阅读并了解 ESD 保护数据表](#)

6.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

6.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

6.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

6.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

6.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

7 修订历史记录

日期	修订版本	注释
2024 年 11 月	*	初始发行版

8 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
MMBZ30VCLDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	3ICG
MMBZ30VCLDBZR.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	3ICG

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

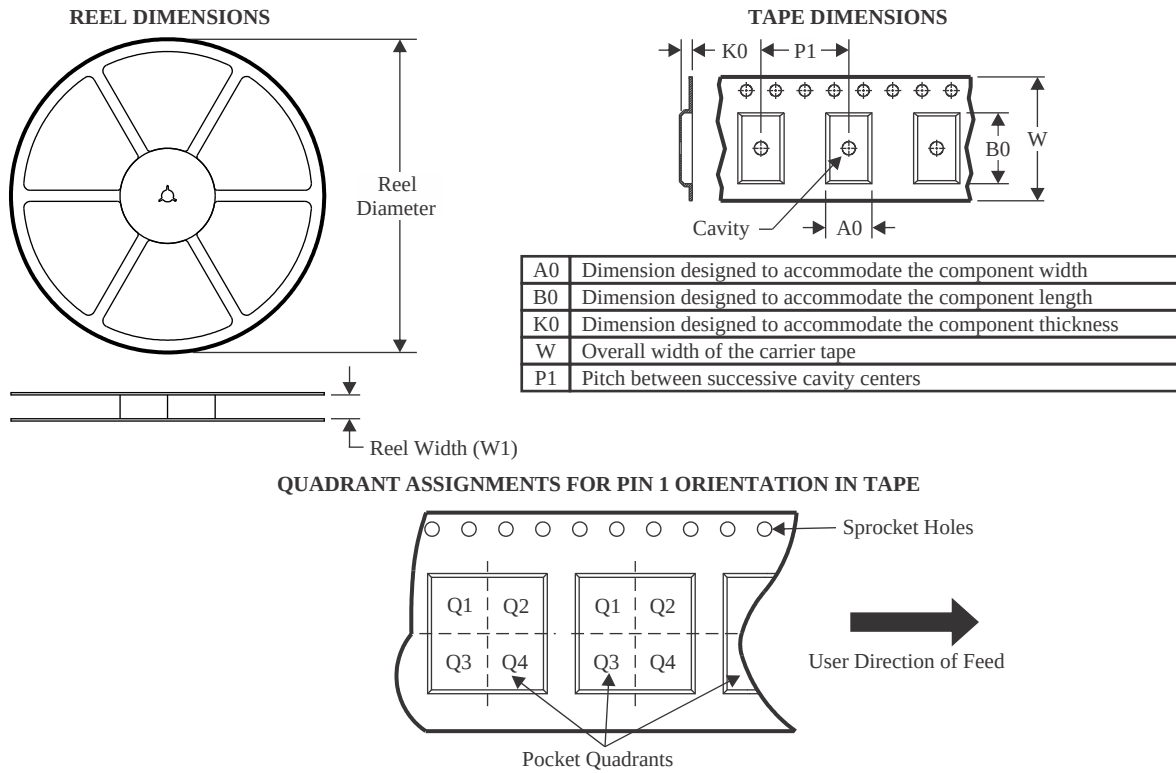
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF MMBZ30VCL :

- Automotive : [MMBZ30VCL-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
MMBZ30VCLDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



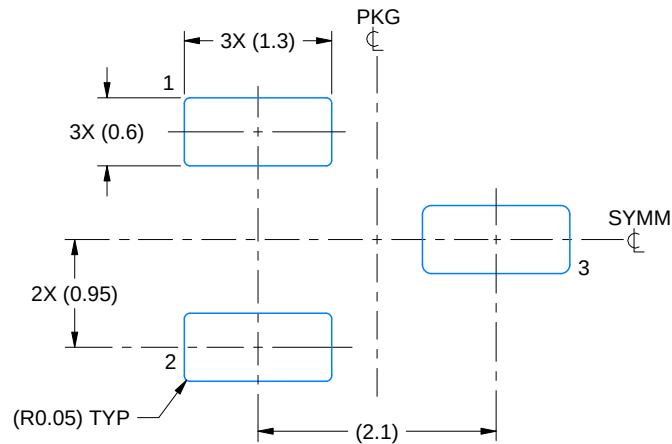
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
MMBZ30VCLDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0

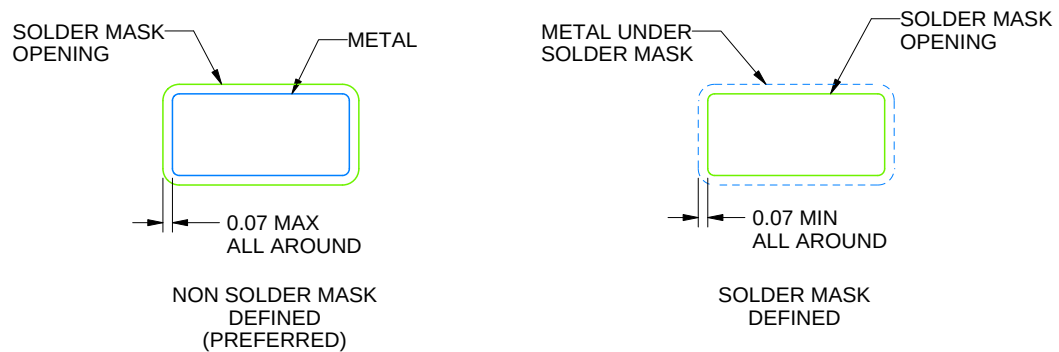
DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

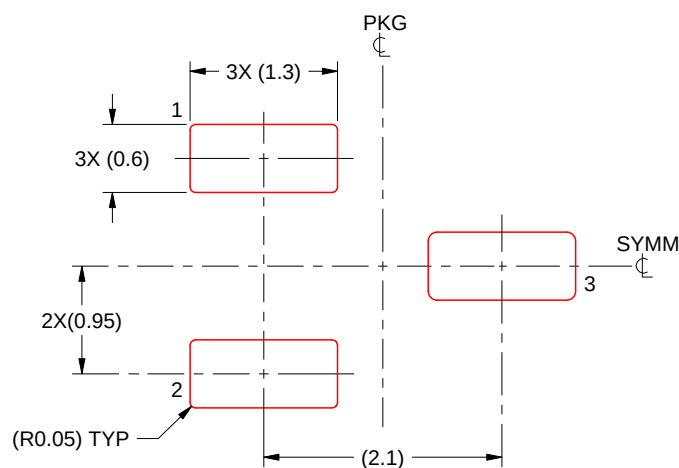
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:15X

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月